

第 6 回 有機/無機接合研究委員会プログラム

日時： 2020 年 3 月 5 日(木) 12:55～16:40

場所： 横浜国立大学 常盤台キャンパス 理工学部講義棟 A202、B 会場(神奈川県横浜市)

時 間	題 目	講 演 者
司会 浅井 竜彦 (富士電機(株))		
12:55 ~ 13:00	委員会議事	
13:00 ~ 13:35	『熱を制御する新しいコンポジット材料』 (35 分)	○竹澤 由高(日立化成(株))
13:35 ~ 14:10	『厚銅セラミックス回路基板向け 活性金属ろう材/銅複合材の開発』 (35 分)	○岸本 貴臣(田中貴金属工業(株))
14:10 ~ 14:45	『粗面化めっき法を用いた鉄鋼と樹脂の異種材料接合』 (35 分)	○新井 進(信州大学)
14:45 ~ 14:55	休 憩	
司会 水野 潤(早稲田大学)		
14:55 ~ 15:55	『フレキシブルハイブリッド有機エレクトロニクス技術の基盤研究と応用展開』 (60 分)	○時任 静士(山形大学)
15:55 ~ 16:40	『MEMS 技術とフレキシブルデバイスー超小型センシングシステムを中心にー』 (45分)	○前中 一介(兵庫県立大学)

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。